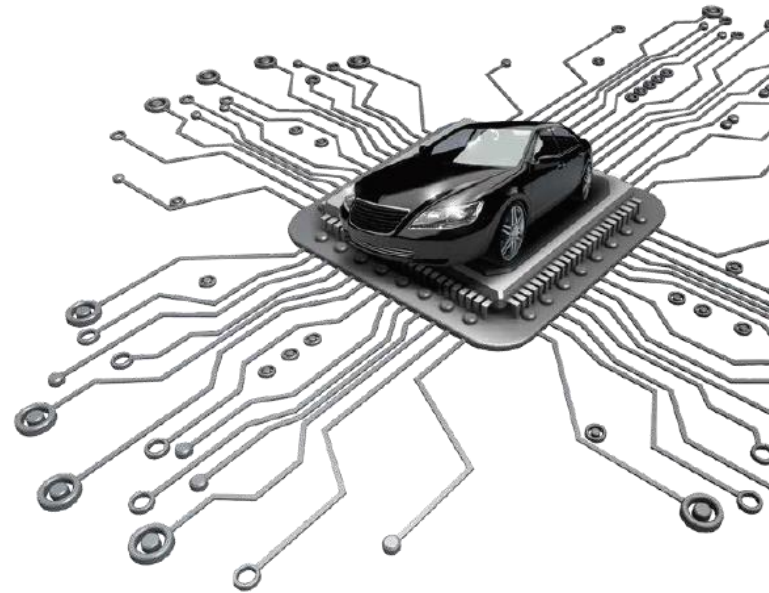




(주) 아이에이(iA, Inc.)

Investor Relations

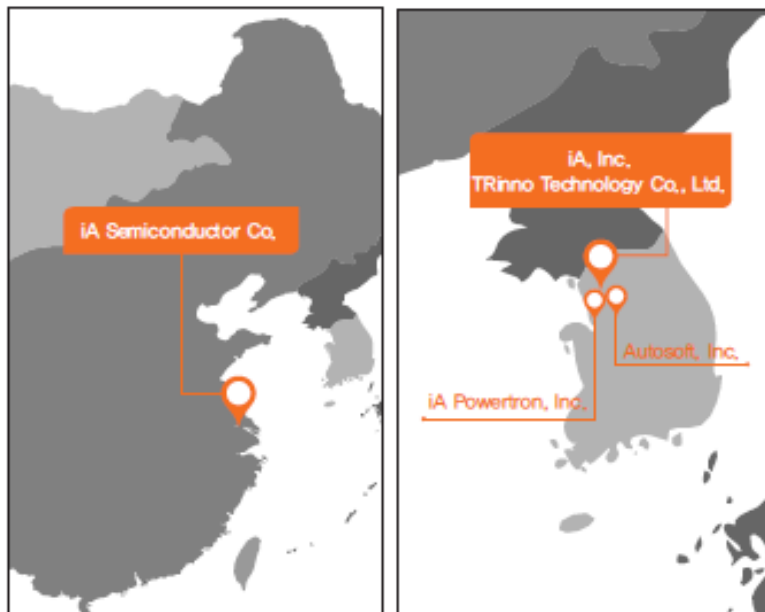


회사 소개

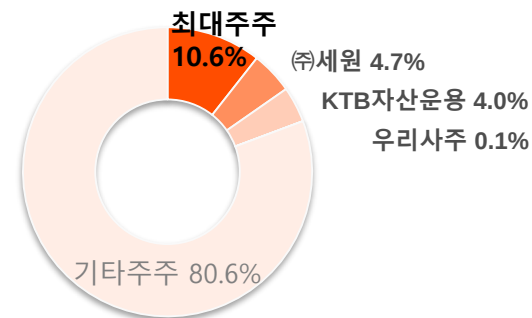
(주)아이에이

설립	1993년 8월
대표이사	김동진
자본금	22,533 백만 원
직원수	343명 (파워트론, 트리노, 오토소프트 포함)
사업분야	자동차용 / 전력 반도체, 모듈 및 솔루션
소재지	서울 송파구 송파대로22길 5-23 아이에이 빌딩
홈페이지	www.ia-inc.kr

계열사 현황



지배구조



- 중국 합자법인
- 전력반도체(IGBT, MOSFET, Diode) 생산 및 판매
- 아이에이 지분율 45.0%



- 전력반도체 개발 및 제조
- 고속 스위칭 소자 (IGBT, MOSFET, Diode)
- 가전기기 및 산업분야 제품에 전력반도체 공급
- 아이에이 지분율 51.0%

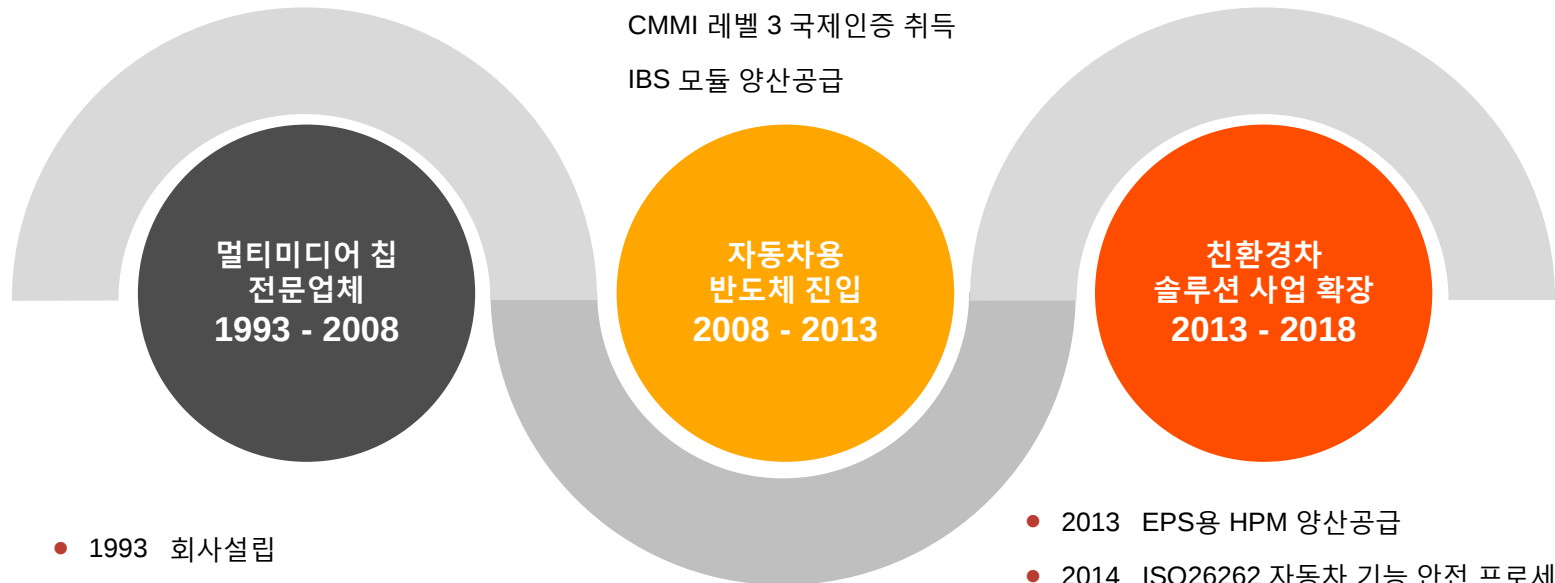


- 전력모듈 개발 및 제조
- 자동차 EPS(Electric Power Steering)용 전력모듈
- 산업용 전력모듈
- 아이에이 지분율 87.7%



- 자동차용 소프트웨어 검증 및 개발
- 현대모비스 AUDIO/AVN 플랫폼 기반의 SW 개발 및 디버깅
- 아이에이 지분율 65.0%

- 2009 자동차용 반도체 국산화 개발 계약 (현대기아차)
- 2010 김동진 회장 취임
- 2011 AVN시스템 제어 칩 양산공급
- 2012 TS16949 및 현대차 SQ인증 획득
CMMI 레벨 3 국제인증 취득
IBS 모듈 양산공급



- 1993 회사설립
- 2000 KOSDAQ 등록
- 2004 DMB 전용 칩 'Neptune' 출시 (국내최초)
- 2006 VoIP 전용 칩 'Cronus' 출시 (국내최초)

- 2013 EPS용 HPM 양산공급
- 2014 ISO26262 자동차 기능 안전 프로세스 구축
- 2015 (주)트리노테크놀로지 경영권 인수
- 2016 (주)하이브론 (現 아이에이파워트론) 경영권 인수
공조제어 칩 양산공급
- 2017 중국합자법인 (iA Semoconductor Co.) 설립
- 2018 HPM 누적 500만개, IBS 누적 800만개 공급

AVN : Audio Video Navigation
EPS : Electric Power Steering
IBS : Intelligent Battery Sensor
HPM : High Power Switch Module

대표이사



대표이사 회장
김 동 진
(金東晉)

주요 경력 및 학력

- 국방과학연구소 (1972~1978)
 - 현대우주항공 대표이사 사장 (1997~1999)
 - 현대자동차 대표이사 부회장 (2003~2008)
 - 현대모비스 대표이사 부회장 (2009)
 - 한국자동차공업협회 회장 (2003~2005)
 - 한국엔지니어클럽 회장 취임 (2015. 02)
 - 한국전력소자산업협회 회장 취임 (2015. 06)
-
- 경기고등학교 졸업 (1968)
 - 서울대학교 기계공학과 (1972)
 - (美)핀레이공과대학원 산업관리학 (공학박사, 1988)

경영철학

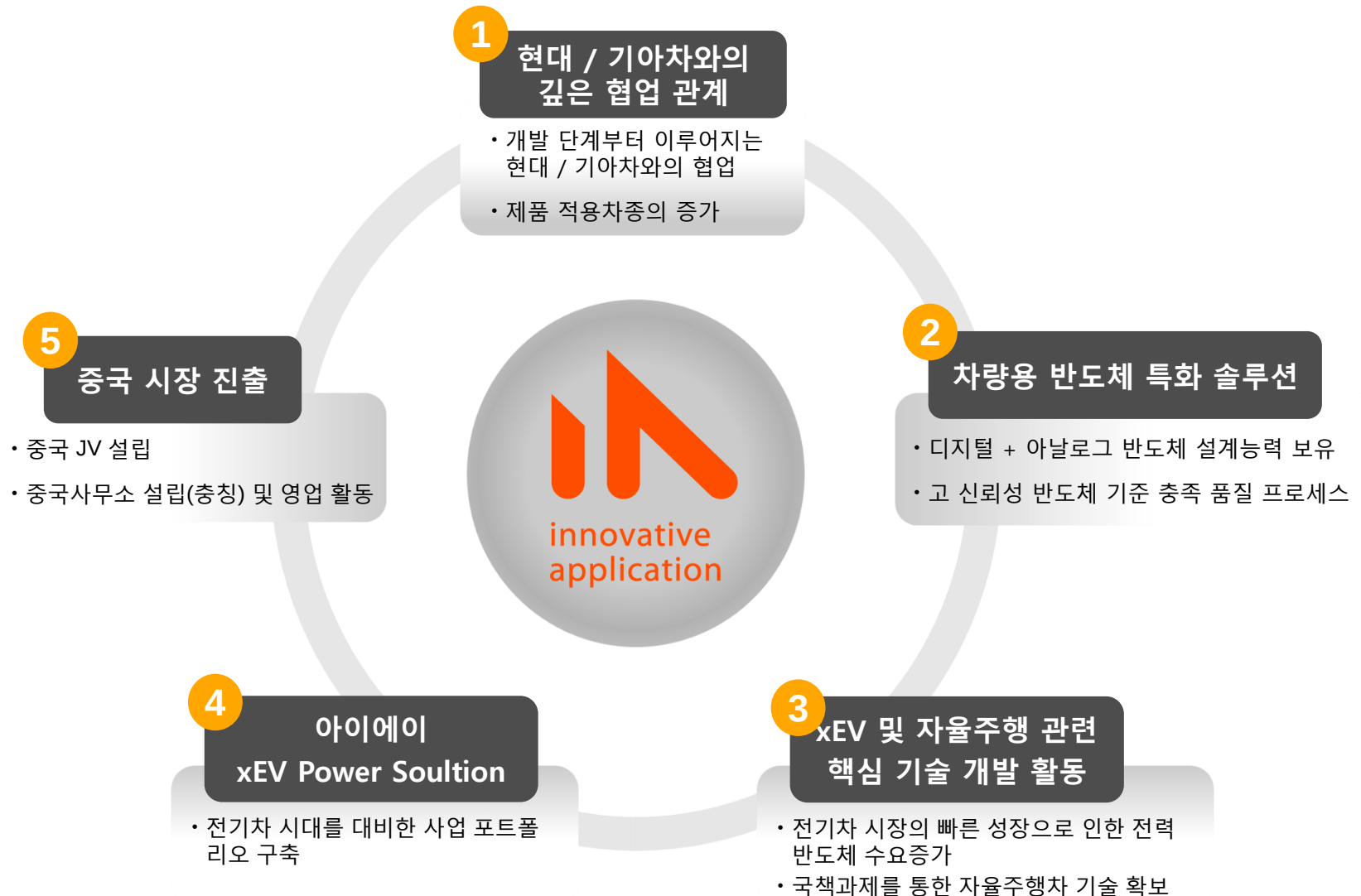
"자동차용 반도체의 기술적 자립 실현을 통한
세계 최고 수준의 반도체 개발"

"지난 30년 동안 한국의 자동차 산업은 세계적인 수준에
올랐지만, '차량용 반도체' 분야만은 아직 선진국에
종속되어 있습니다.

내 손으로 국산 자동차에 장착할 수 있는 최고 수준의
반도체를 개발해 완전한 기술 자립을 실현하는 것이
목표입니다. "

- 2010. 3. 30일 매일경제신문, 대표이사 인터뷰 기사 中 -

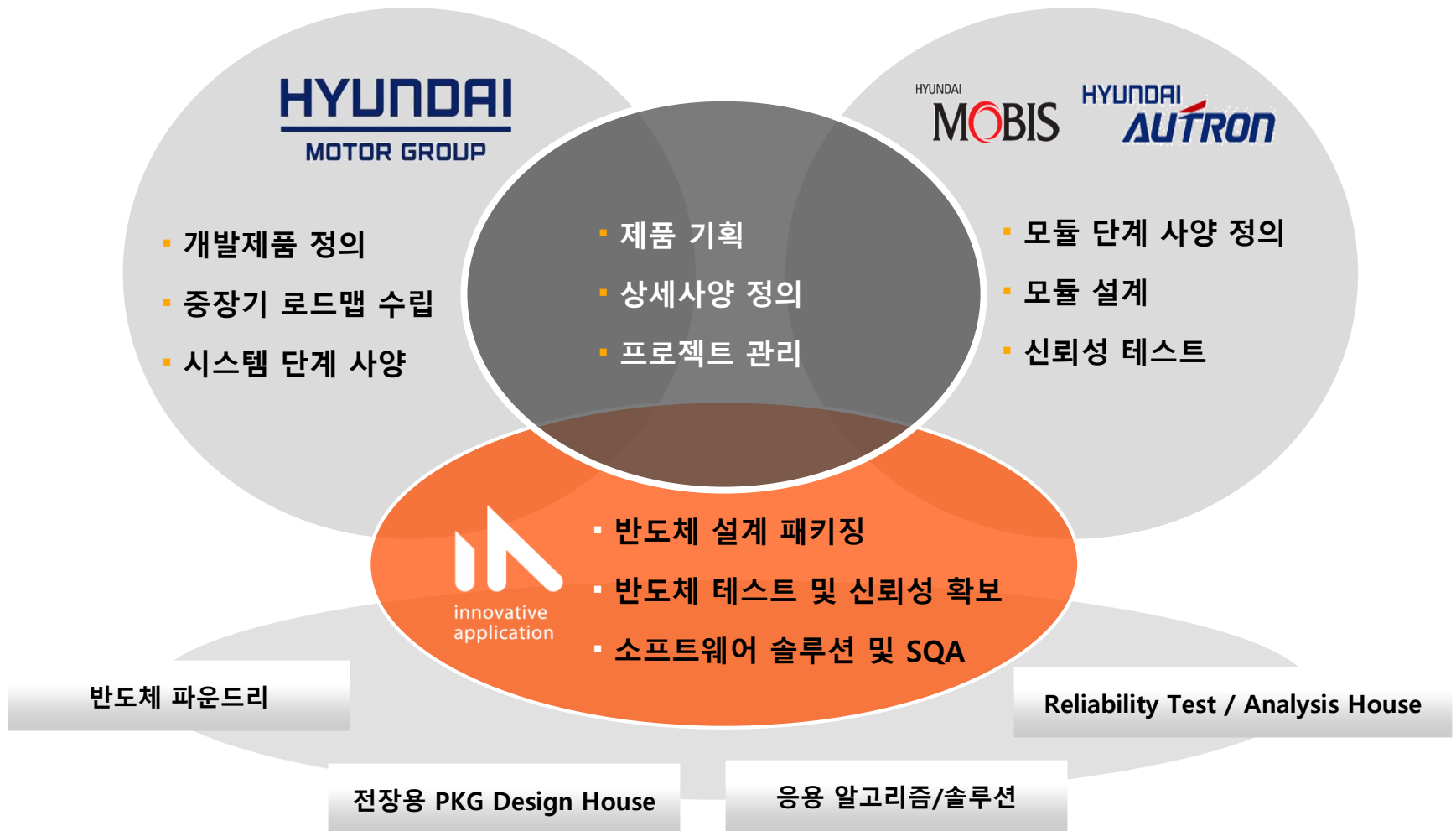
사업 소개



1 현대 / 기아차와의 깊은 협업 관계



2009년 부터 현대/기아차—모비스(오토론)과의 협업을 통해 맞춤형 반도체를
적기에 공급하는 개발 체제 및 사업 구도를 전개하였음



1 현대 / 기아차와의 깊은 협업 관계



Infotainment 분야를 시작으로 Body/Chassis 분야와 Powertrain에 이르는
고 신뢰성 자동차용 반도체 국산화를 목표로 개발하고 있음

Stage 1 : Infotainment

▪ 자동차용 반도체 시작

- Consumer 제품 개발 경험 기반 멀티미디어 중심의 infotainment 반도체



Stage 2 : Body / Chassis

▪ 확대 적용 및 기술 축적

- 편의기능 중심의 Body용 반도체
- 안전기능을 제공하는 Chassis용 반도체



Stage 3 : Powertrain

▪ 고난도 핵심 기술 확보

- 엔진 제어 시스템
- 고전력 파워 반도체
- 전력제어 -트랙션 모터 제어기

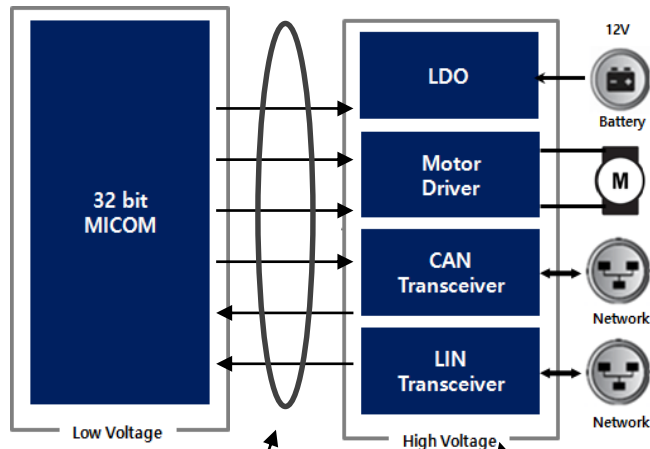


2 차량용 반도체 특화 솔루션



차량용 반도체는 대부분 고 전압 아날로그와 디지털의 혼합 형태로 구성이 되며
회사는 하드웨어와 소프트웨어를 포함하는 반도체 종합 솔루션을 제공함

기존 방식



MICOM과의 1대1 연결방식
→ PCB 복잡도 증가

외부 디바이스 필요



MCU
(디지털)



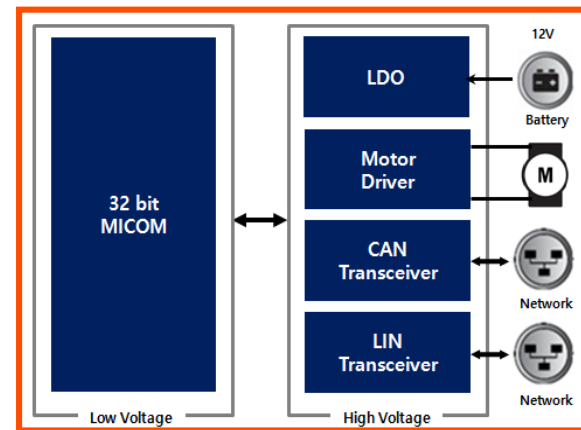
LIN/CAN PHY
Memory
Watch-Dog
(통신)



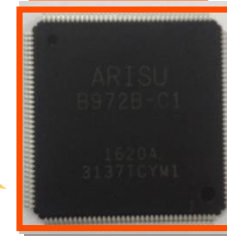
Motor Driver
LDO
(아날로그)

외부 디바이스
통합
→
PCB 최적화에
따른 시스템
비용 절감

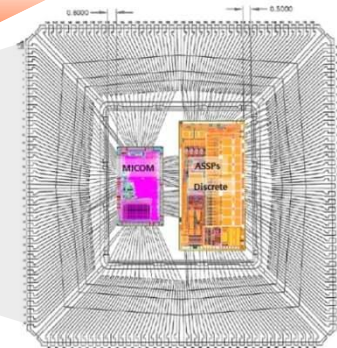
아이에이 ASIC 솔루션



One-chip



HVAC ASIC



2 차량용 반도체 특화 솔루션



고 신뢰성 반도체 기준에 충족하는 제품 생산을 위한 ISO26262, CMMI레벨3, TS/ISO16949
세가지 품질 프로세스/기준을 보유 및 획득한 국내 유일의 팹리스 업체

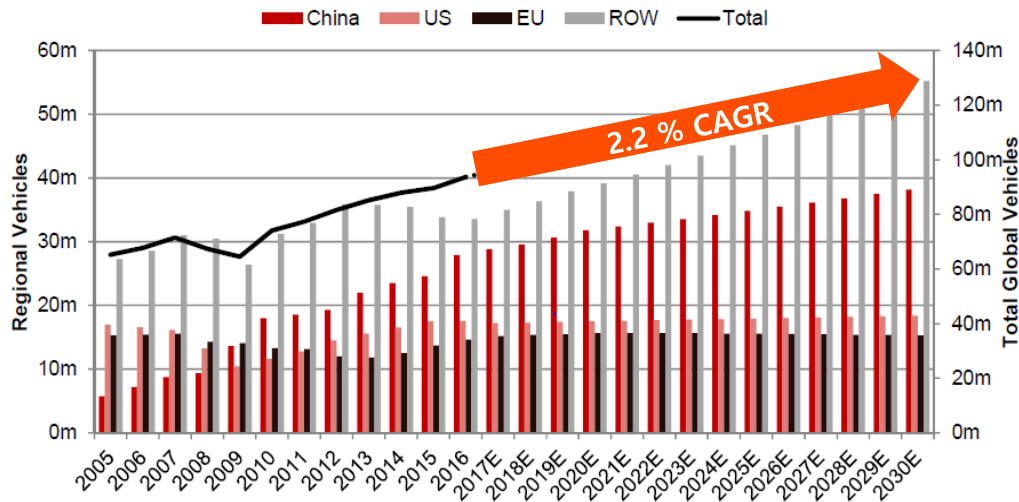
	구분	인증명	취득일	인증기관
1	(주)아이에이 본사	ISO 9001:2008 Quality Management System	2009.10.11	BSI FM 555258
		ISO 14001:2004 Environmental Management System	2009.10.25	BSI EMS 555259
2		CMMI-DEV v1.3 (Level3) Capability Maturity Model Integrations	2012.10.23	TQMS 19087
3		ISO26262 기능 안전 프로세스	2016. 6. 7	TUV-Rheinland
4	(주)아이에이 EP공장	ISO/TS16949:2009 Quality Management System	2013. 8. 13	UL 502510 TS09
5		SQ 인증 (협력사 품질 보증 평가)	2012. 8. 20	현대모비스 현대자동차 EL414(B)
6	파워트론 본사	SQ 인증 (협력사 품질 보증 평가)	2012. 10. 11	현대모비스 현대자동차 EL419
7		ISO/TS16949:2009 Quality Management System	2014. 7. 27	DQS (UL, DIN, & DGQ) IATF:0189210 CASC:2014A235
8		ISO 14001:2004 Environmental Management System	2014. 6. 19	ICR E145711
9	(주)트리노테크놀로지 Back-End FAB	ISO 14001:2004 Environmental Management System	2010. 2. 5	ISC GLOBAL
10		ISO/TS16949:2009 Quality Management System	2016.11.29	SAI GLOBAL

3 xEV 및 자율주행 관련 핵심 기술 개발 활동



글로벌 자동차 수요는 2017년부터 2030년까지 연평균 2.16%, xEV의 경우 같은기간 연평균 23.3% 증가를 예상하고 있으며 전체 자동차 대비 xEV 비중은 4%에서 41.4%까지 늘어날 것임

글로벌 자동차 수요 추정



2017년

2030년

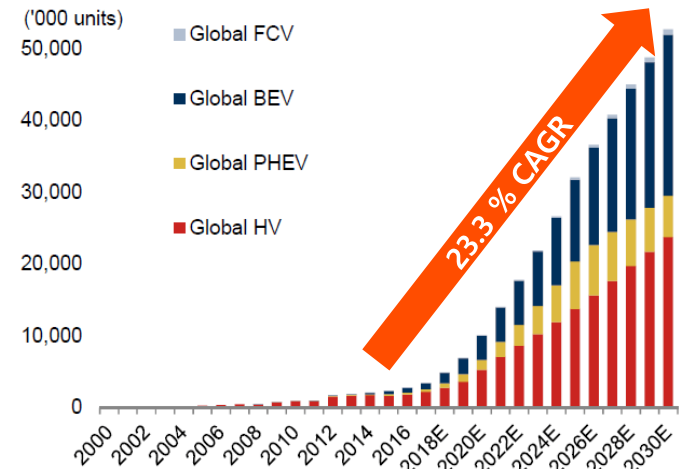
(단위: 대)

9천
600백만

중국 2.18% CAGR
미국 0.5% CAGR
유럽 0.1% CAGR
그 외 4.4% CAGR

1억
3천만

글로벌 xEV 대수 예상



Source: Fourin, JAMA, Marklines, European Environment Agency, ICCT, Ward's Automotive, Autodata, Nomura estimates, Instinet research

ICE: Internal Combustion Engine
FCV: Fuel Cell Vehicles
BEV: Battery Electric Vehicles
PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle
HV: Hybrid Vehicle

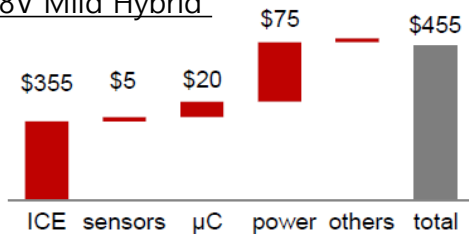
3 xEV 및 자율주행 관련 핵심 기술 개발 활동



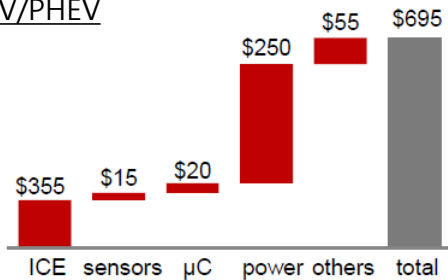
전통 내연기관차(ICE)는 차량 1대당 평균 335달러 가치의 반도체 탑재, 전기차(EV)는 평균 695달러로 2배 이상 증가
특히 EV의 파워트레인이 주요 가치 증가요인으로, 그 중 전력반도체 및 모듈이 가장 큰 부분을 차지함

자동차 1대당 탑재된 반도체 가치

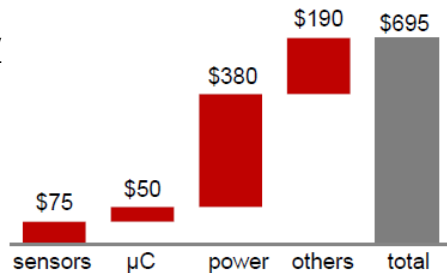
48V Mild Hybrid



HEV/PHEV



EV



Source: Nomura, based on Infineon data

PHEV에 적용되는 전력 반도체 및 모듈

On Board Charger

- PFC Boost
- 1200V/90A SiC MOSFET
- 1200V/50A SiC Diode
- Isolated DC-DC converter
- 650V/120A GaN Full Bridge
- 650V/50A Si Diode Full Bridge

High Voltage DC-DC

- Primary DC-DC converter
- IGBT, Diode (650V/200A)

Low Voltage DC-DC

- Secondary DC-DC converter
- MOSFET (100V/180A)

e-Compressor, Air Blower Inverter

- IGBT, Diode (650V/200A)

Traction Motor Control System

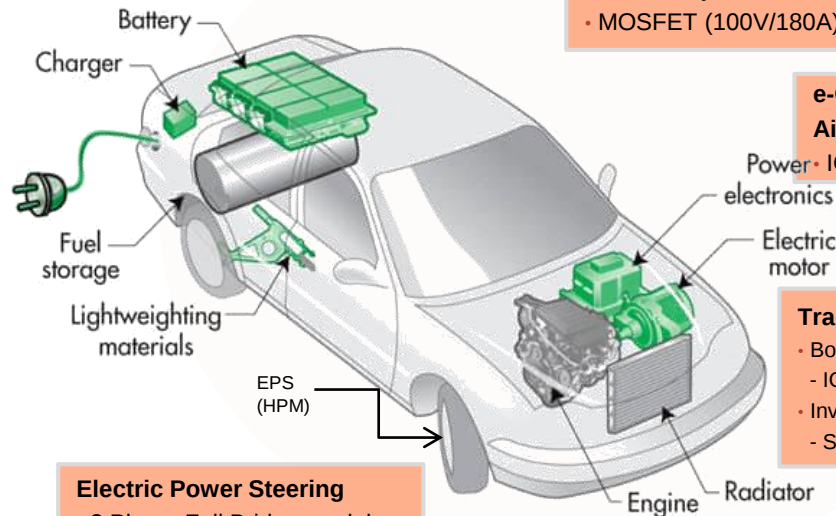
- Boost converter
- IGBT, Diode (650V/200A)
- Inverter / Motor Generator
- SiC MOSFET (650V~1200V)

Electric Power Steering

- 3 Phase Full Bridge module
- MOSFET (40V/160A)

Water Pump Inverter

- IGBT, Diode (1200V/50A)



3 xEV 및 자율주행 관련 핵심 기술 개발 활동

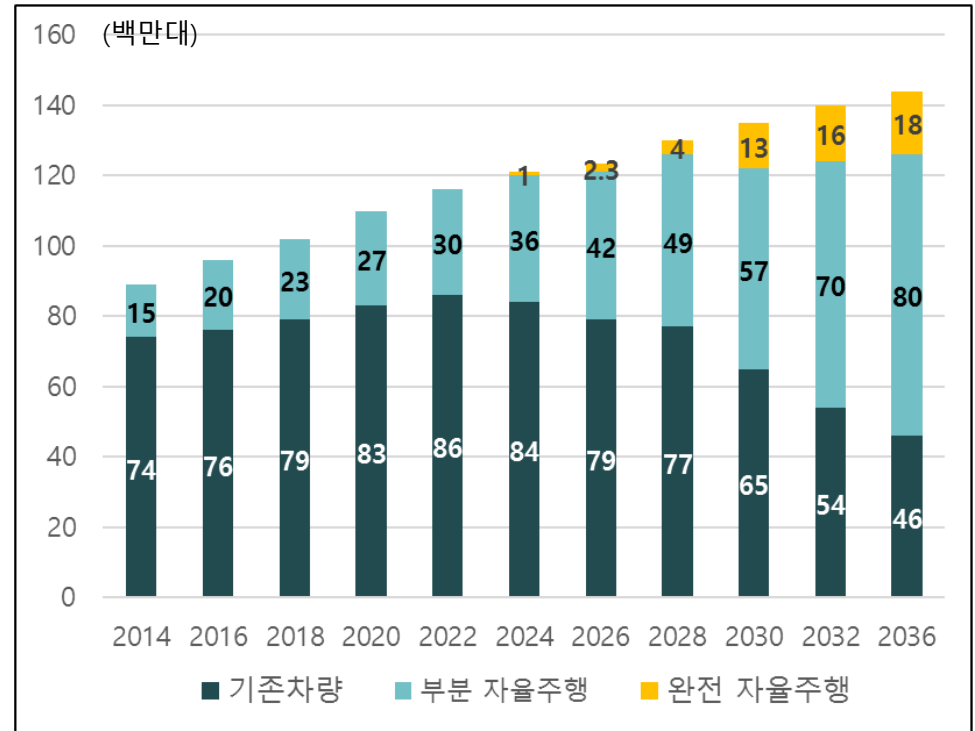


자율주행의 기술적 배경

구분	기대효과
교통사고 감소	- 운전자 실수에 의한 교통사고 방지 - 국토부, 자율 주행차 상용화시 2025년까지 교통사고 사망자 수 절반 수준 감소 전망 - McKinsey는 자율주행차가 미국 교통사고 90% 줄일 것으로 예측
교통 정체 해소/완화	- 안전한 차간 거리 유지 및 적절한 속도 관리로 교통정체 유발 해소 - 교통 정체로 연결되는 운전 억제
고령화 대응 등	- 고령자 운전 능력 대체 및 보완을 통한 고령자 이동 수단 확보 - 대중교통 보완 - 대중교통 정류장으로부터 목적지까지 자율 주행

자율주행차 시장 전망

- 구글, 삼성 등의 연구진이 Applied Innovation Review에 기고한 바에 따르면 2단계 이상 자율주행 기능을 탑재한 차량의 비중은 2014년 17%에서 2020년에 25%로 상승할 전망
- 완전 자율주행을 탑재한 차량은 2025년부터 빠르게 늘어날 전망**



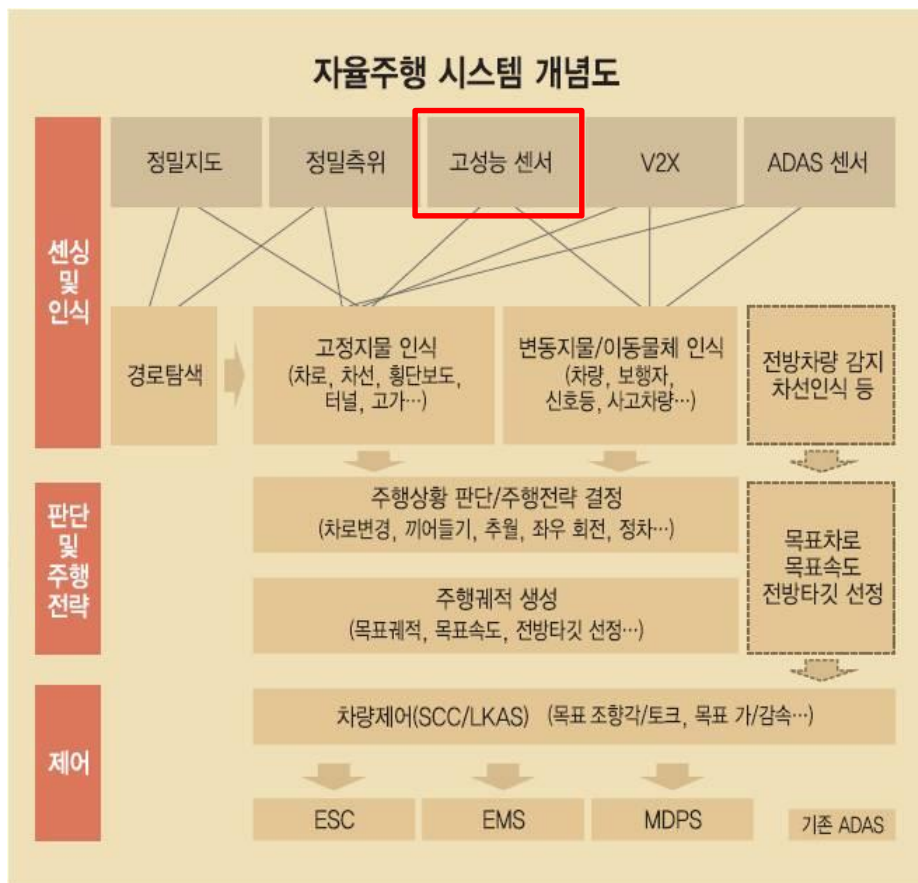
* Source : Applied Innovation Review(2015), 한국투자증권

3 xEV 및 자율주행 관련 핵심 기술 개발 활동



자율주행 시스템의 핵심은 고성능 센서로

레이더 센서 및 영상 센서는 자율주행 자동차 10대 핵심부품으로 선정 (산업통상자원부)

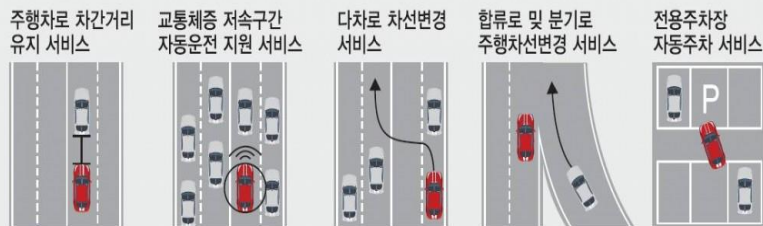


자율주행 자동차 10대 핵심 부품

- ① 레이더 센서
- ② 영상 센서
- ③ 개인화 모듈
- ④ 자율주행 기록장치(ADR)
- ⑤ V2X 통신 모듈
- ⑥ ADAS 지도
- ⑦ 복합측위모듈
- ⑧ 스마트 액추에이터
- ⑨ 운전자 차량인터페이스(HMI) 모듈
- ⑩ 차세대 차량네트워크(IVN) 도메인컨트롤유닛(DCU)



자율주행 자동차 5대 시스템



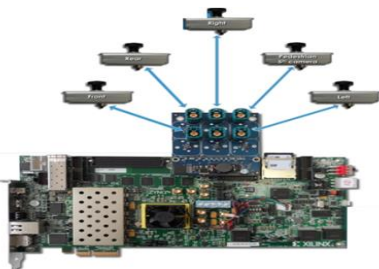
3 xEV 및 자율주행 관련 핵심 기술 개발 활동



• 카메라 기반 인공지능 시스템 개발

도로 환경 검출 및 도로 객체 인식을 동시에 실시간 처리 가능한 인공지능 기반 고성능 통합형 시스템 개발

- 개발기간 : 2017. 11 ~ 2021. 12 (50개월)
- 사업규모 : 총 53억원 (정부지원 50억원)
- 아이에이는 카메라 기반 인공지능 시스템을 소형의 모듈로 개발하고 자동차 환경에서 신뢰성 테스트 수행
- 자동차용 반도체를 성공적으로 개발하고, 국산화한 경험을 바탕으로 자동차용 반도체 설계 가이드를 제공하고 향후 개발 결과물의 상용화까지 핵심역할을 담당



Camera based AI system board



Example of autonomous driving based on camera image information

사업적 영향

카메라 기반 인공지능을 탑재한 소형 모듈로 제품화 하여 차량에 적용하는 사업화를 추진 또한 인공지능 알고리즘을 적용한 FPGA를 SoC 상품화하는 계획도 고려

국내시장은 현대기아차와 사양 협의 및 단계적 개발 협의를 통해 차량 적용을 추진

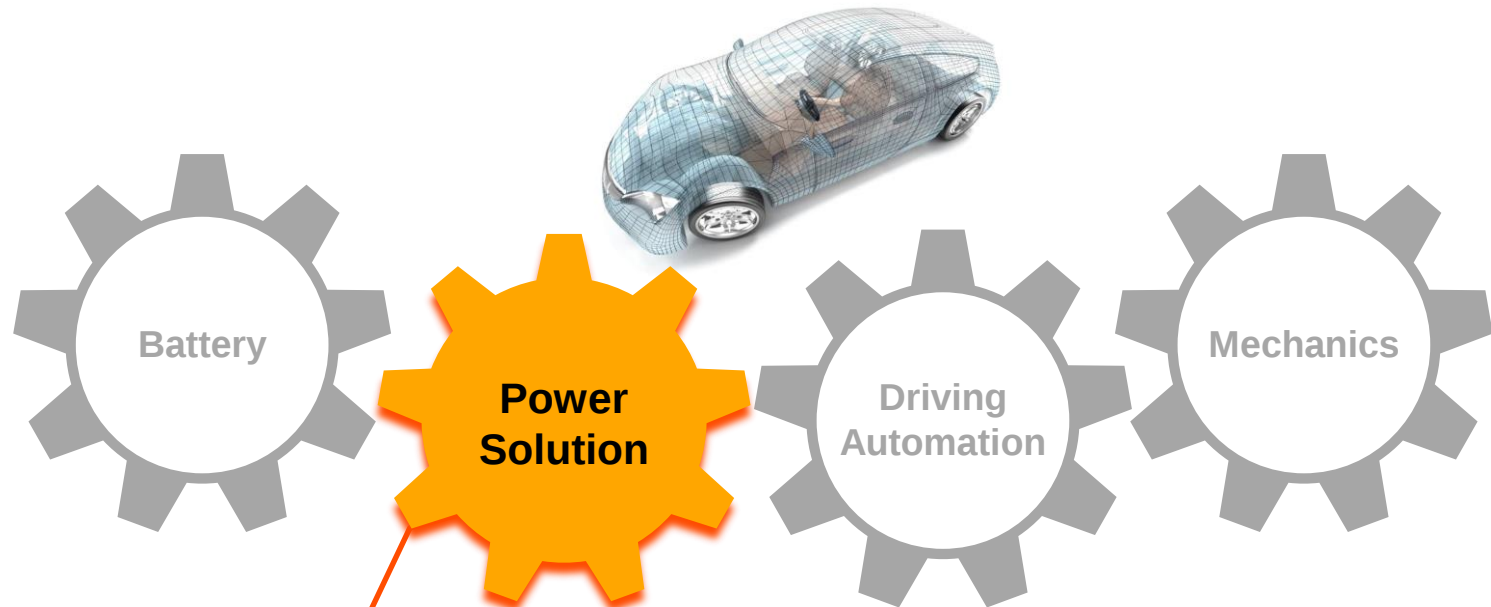
중국시장은 동풍자동차, 지리자동차 등을 중심으로 개발 초기부터 영업 활동을 추진할 계획이며, 자율주행 알고리즘 모듈 제품 개발이 완료되는 2022년에는 차량 적용 및 양산화를 통해 매출에 기여하고자 함.

17

4 아이에이 xEV Power Solution



회사는 빠르게 부상하는 전기차 시장에 대응하기 위해 사업포트폴리오를 강화하였으며
특히 Power Solution 제품에 집중을 하고 있음



▪ Traction

- DC-DC Converter / Inverter / IPM / Motor Controller

▪ Battery Charging

- On-Board Charger / Power Station

▪ Thermal Management System

- HVAC / e-Compressor / PTC

▪ Mild Hybrid

- BD DC-DC converter / ISG

▪ EPS (Electric Power Steering)

4 아이에이 xEV Power Solution



고객사 시스템 성능 향상을 위한 최적화된 전력 반도체 모듈 개발 및 양산

iA PowerTron (전 Hivron)



제1 공장 (Gel-fill 공정 용)

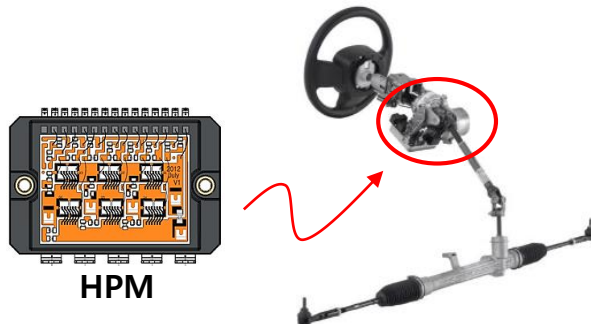


제2 공장 (Transfer Molding 공정 용)

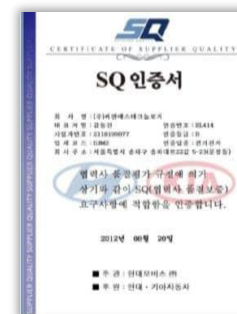


반도체와 모듈을
포함하는
Total Solution 제공

Electric Power Steering System (EPS)



인증 현황



4 아이에이 xEV Power Solution



자사 전력반도체 소자와 모듈 제품을 활용한 각 종 원가경쟁력 확보 최적화 전장용 모터 제어기 개발
센서 없는 전동기 구동 기술 / 구동 제어 기법 / 최적 Cost 회로 설계 기법

e-Compressor Controller

중국 C사, 연간 5만대 공급 계약 진행
(2019년 말 양산)

PTC Heater Power Module

중국 C사, 자사 모듈 적용하여 검토

e-Water Pump Controller

중국 X사, 60/100W 개발 추진 중
한국 C사, xEV용 23W 개발 추진 중

Cooling Fan Motor Controller

유럽 Tier1, 연간 100만대 개발 진행 중
(2021년 양산)
북미 Tier1, 연간 60만대 개발 진행 중
(2021년 양산)

시스템 에어컨용
E-Compressor

E-Compressor

한국 A사, 7.6kW개발 추진 중

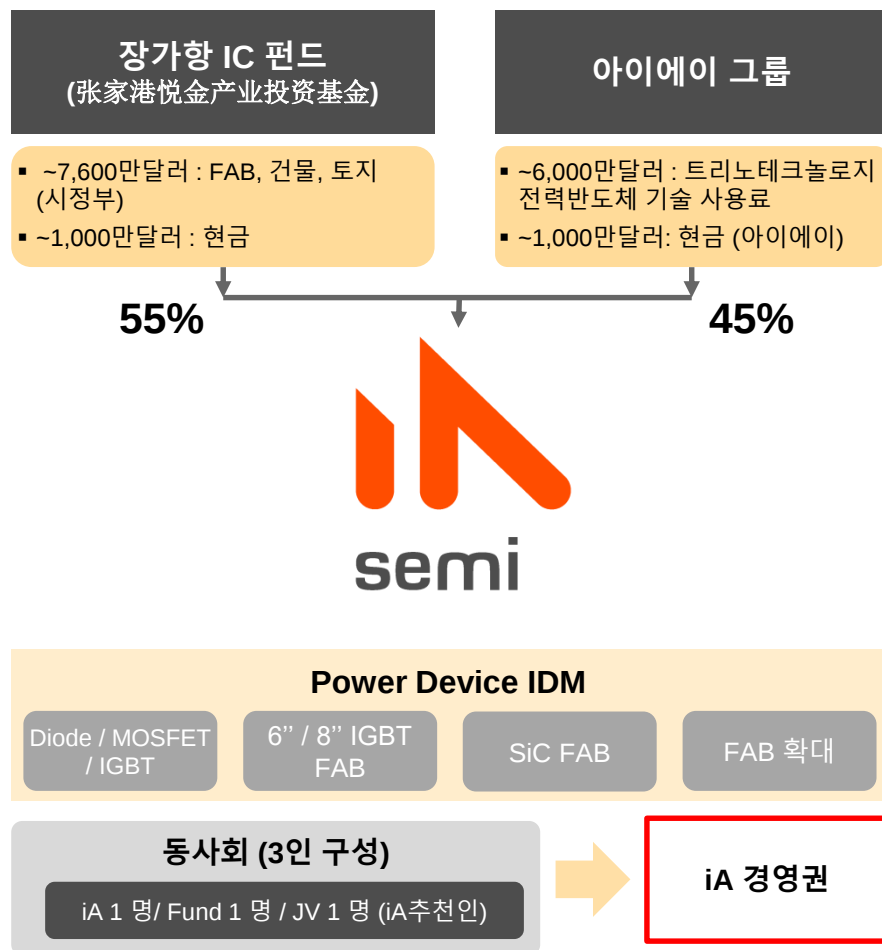


5 중국시장 진출



회사는 대당전신투자 및 장가항시와 설립한 합자회사 “아이에이 반도체 기술유한공사”를 통해 중국 시장진입 및 사업확장에 안정적인 기틀을 마련했음

딜 구조



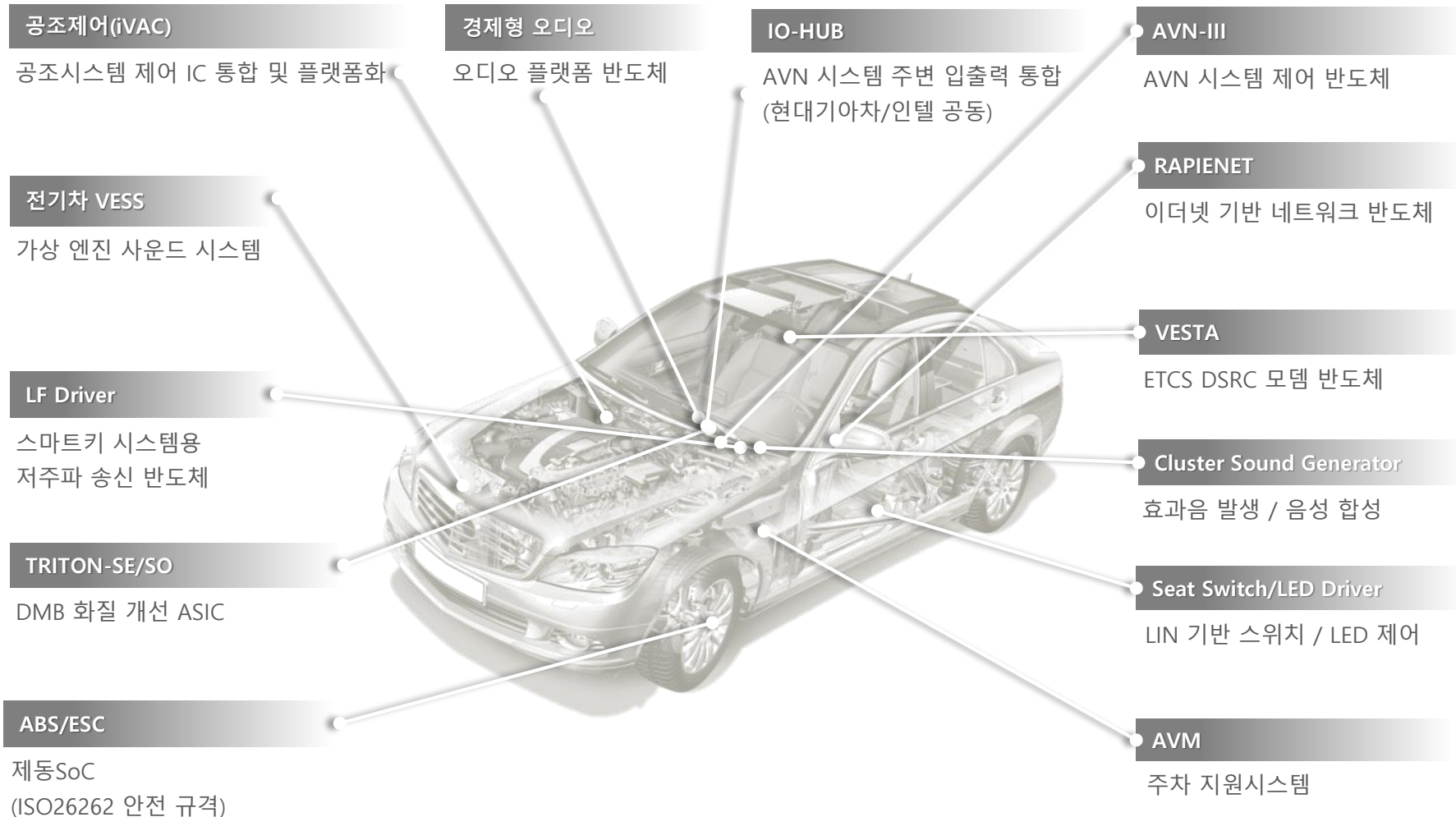
주요 내용

- 아이에이는 세계 최대 전기차 시장인 중국에 진출하기 위해 2018년 3월 20일에 중앙정부기업 대당전신 (투자담당 자회사) 및 상해 근교에 위치한 장가항 시정부와 함께 합자법인을 설립
- 합자법인(아이에이 반도체 기술유한공사)은 전기차를 비롯한 친환경자동차 산업을 활성화 시키려는 장가항시의 적극적인 유치 노력과 자동차 및 전력반도체 분야에서 우수한 기술력을 갖춘 아이에이와 트리노테크놀로지의 중국 진출 노력이 결합한 결과
- 지분구조:
 - 장가항 IC펀드 55% (GP: 대당전신투자)
 - 아이에이 그룹 45% (아이에이 6.2%, 트리노 38.8%)
 - 자본금: 1.57억 달러
- 트리노테크놀로지의 38.8% 지분 출자는 전력반도체 관련 핵심기술 및 노하우에 대한 기술사용료를 수령하여 출자로 활용

5 중국시장 진출



주요 제품



HD-DMB

고화질 DMB 모듈/솔루션

T-DMB

DMB 화질 개선 모듈

DAB+

유럽 DAB+

CMMB

중국 Mobile TV

IBS

지능형 배터리 센싱 모듈

E-Relay module (Transfer Molding)

FET 스위칭 전류보호를 위한
역전압 보호 릴레이 모듈

HPM Gen 2.0 / 2.5 (Gel-fill)

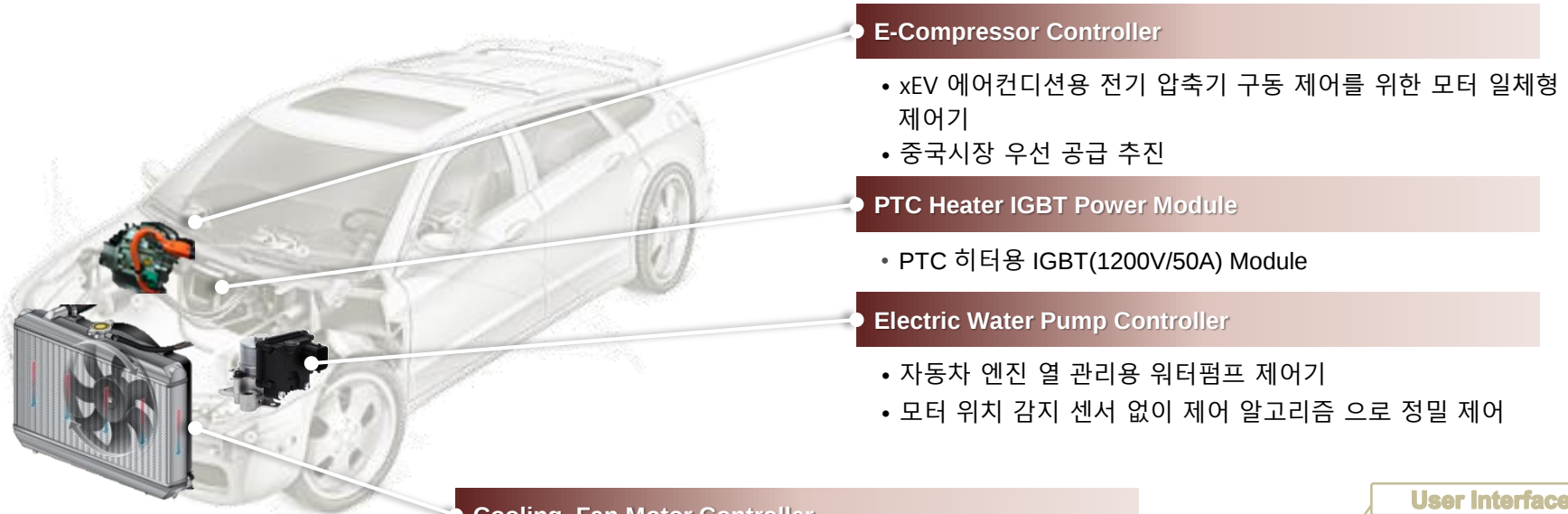
EPS 모터 구동용 3상 인버터 모듈
40V/160A MOSFET 모듈

HPM Gen 4.0 (Gel-fill)

40V/160A MOSFET 모듈 + 전류센서

N3 플랫폼 HPM-M (Transfer K3 플랫폼 HPM-M Molding)

40V/160A MOSFET 모듈 + 전류센서

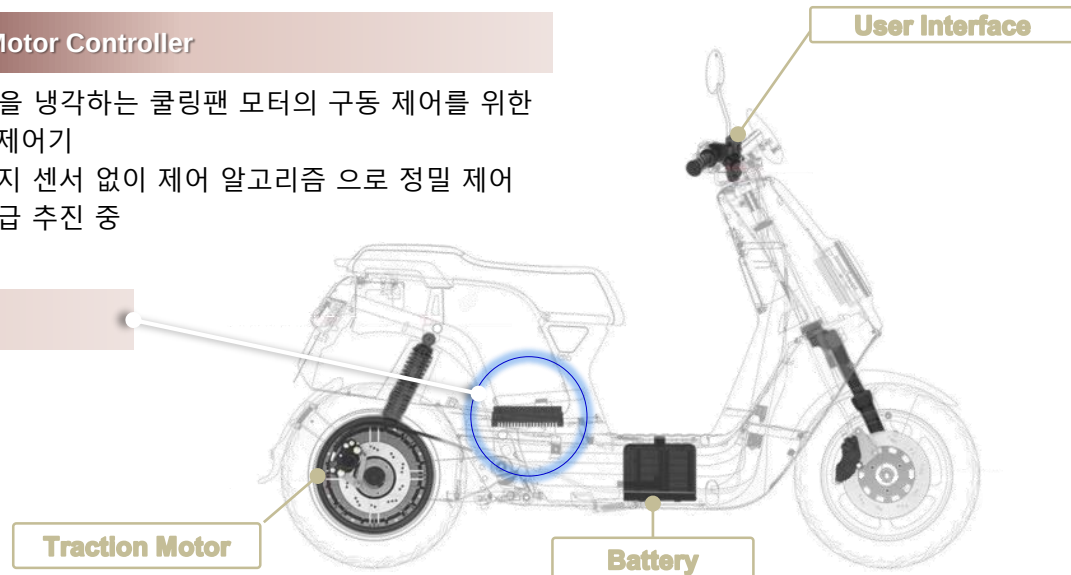


Cooling Fan Motor Controller

- 엔진/모터 열을 냉각하는 쿨링팬 모터의 구동 제어를 위한 모터 일체형 제어기
- 모터 위치 감지 센서 없이 제어 알고리즘 으로 정밀 제어
- 중국 시장 공급 추진 중

Traction Motor Controller

- E-Scooter의 트랙션 모터(엔진) 구동 제어를 위한 제어기



계열사 소개

爱特微 (张家港) 半导体技术有限公司

소재지	중국 강소성 장가항시
설립	2018년 3월
자본금	1.57억 달러
직원수	238명
대지면적	33,334m ²
capacity	30,000장/월

공정 능력

- 8V-60V, 2um Bipolar technology
- 1.2um N channel CMOS technology
- 3.0um BICMOS technology
- PLANAR NPT 1200V IGBT technology
- PLANAR NPT 500V-600V IGBT
- 600V-1200V FRD technology
- 600V-1200V HVDMOS technology



Virtual IDM



Si기반 IGBT, MOSFET부터 SiC 에 이르는 전 영역에서 고효율, 고품질의 전력 반도체 솔루션 공급

■ 핵심 역량



최신 파워반도체 설계 기술 보유

- Field Stop Trench IGBT
- Super Junction MOSFET
- Split Gate Trench MOSFET
- Silicon Carbide MOSFET & SBD



높은 품질/환경 관리 시스템

- ISO/TS16949 (전장부품)
- ISO14001 (환경)
- 고객별 품질관리 시스템 운영



글로벌 공급 망 운영

- 중국 JV 설립과 웨이퍼 가공 공장 가동
- 초박막 웨이퍼 프로세스 R&D센터 운영
- 국내, 해외 우수 조립생산 얼라인

■ 사업 분야



산업용 전원장치

- 용접기
- 인버터 시스템
- 무정전전원장치
- 통신용 전원
- 모터드라이브



신재생 에너지

- 태양광 인버터
- 에너지 저장장치
- 배터리 전원관리



생활 가전

- 인덕션 쿠키
- 에어컨
- LED 조명

■ 미래사업 역량 강화

자동차용 고효율 반도체 사업화 가속

- DC/DC 컨버터
- 배터리 매니지먼트 시스템
- 모터 드라이브
- 충전 장치

화합물 반도체 조기 상용화

- 1200V, 1700V SiC MOSFET
- 650V, 1200V, 1700V SBD

단위 공정 서비스 비즈니스화

- 초박막 웨이퍼 프로세스 (< 70μm)
- 웨이퍼 후면 가공 공정 프로세스
- 이온 주입 프로세스
- 메탈 증착 프로세스



Product Portfolio



IGBT

RC IGBT

- IGBT와 DIODE가 한 칩 구성된 제품
- 600V
- 1350V

Field Stop Trench IGBT

- 진보된 2세대 FS IGBT 제품
- 낮은 $V_{ce(sat)}$ 시리즈 (600V, 650V)
- 고속 스위칭 시리즈 (600V ~ 1350V)
- 단락 회로 능력 시리즈 (600V, 1200V)

하이브리드 IGBT*

- 실리콘 IGBT와 SiC SBD 조합된 제품
- 650V
- 1200V

NPT Trench IGBT

- 내구성이 우수한 1세대 제품
- 600V
- 1200V



MOSFET

SJ MOSFET

- 높은 전압의 고효율 제품
- 스탠다드 시리즈 (600V)
- 빠른 역회복 시리즈 (650V)*

Trench MOSFET

- 낮은 전압의 고효율 제품
- 스탠다드 시리즈 (40V)
- 분리형 게이트 시리즈 (100V)*
- AEC Q101 인증 제품

Planar MOSFET

- 일반적인 MOSFET 제품
- 200V ~ 900V

SiC MOSFET*

- SiC 기반의 고효율 제품
- 1200V
- 1700V



DIODE

Silicon 다이오드

- 실리콘 기반의 일반적인 제품
- 스탠다드 타입 (600V, 1200V)
- 빠른 역회복 시리즈 (600V, 1200V)

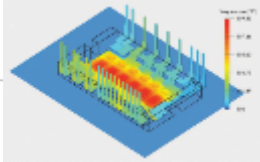
SiC 다이오드*

- SiC 기반의 고효율 제품
- 650V
- 1200V
- 1700V

* 개발 중

고객사 시스템 성능 향상을 위한 최적화된 전력 반도체 모듈 개발 및 양산

■ 핵심 역량



시뮬레이션

- 열해석
- 기구해석
- 회로분석



설계 전문성

- PRO-E
- CATIA
- AUTO CAD



공정 개발

- 진공 솔더링
- Sintering
- 초음파 웰딩



전용 라인 구축

- Gel-Fill 모듈
- Transfer Molded 모듈



품질 관리 (자동차 안전부품 관리기준)

■ 사업 분야



자동차

- EPS 시스템
- MHSG
- 충전 시스템
- 전력변환 장치



일반 산업 분야

- 인버터 시스템
- 전력변환 장치
- 용접 / 유도가열
- 의료 기기



신재생에너지

- 태양광 인버터
- ESS

■ 주요 인증 현황



TS16949

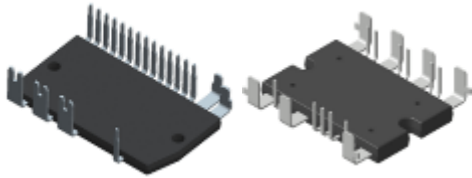


ISO14001



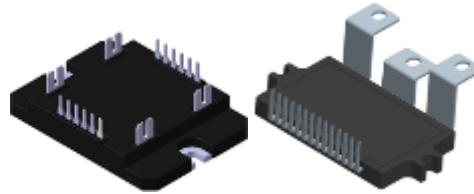
SQ (현대자동차)

Product Portfolio



Automotive

- **EPS (3 phase MOSFET) 모듈**
 - EPS 모터 제어용 파워 모듈
 - 고객 전용 EPS 모듈
 - 표준형 EPS 모듈
- **E-Relay MOSFET 모듈**
 - EPS 시스템용 전자식 릴레이 모듈
 - 40V MOSFET 모듈
- **MHSG 파워 모듈**
 - 48V MHSG 모터 제어용 파워 모듈
 - 80V~100V 3 phase MOSFET 모듈
- **E-Compressor용 IGBT 모듈**
 - E-Comp. 모터 제어용 파워 모듈
 - 650V 3 phase IGBT 모듈
- **PTC Heater용 IGBT 모듈**
 - PTC Heater 전용 파워 모듈
 - 1200V IGBT 모듈



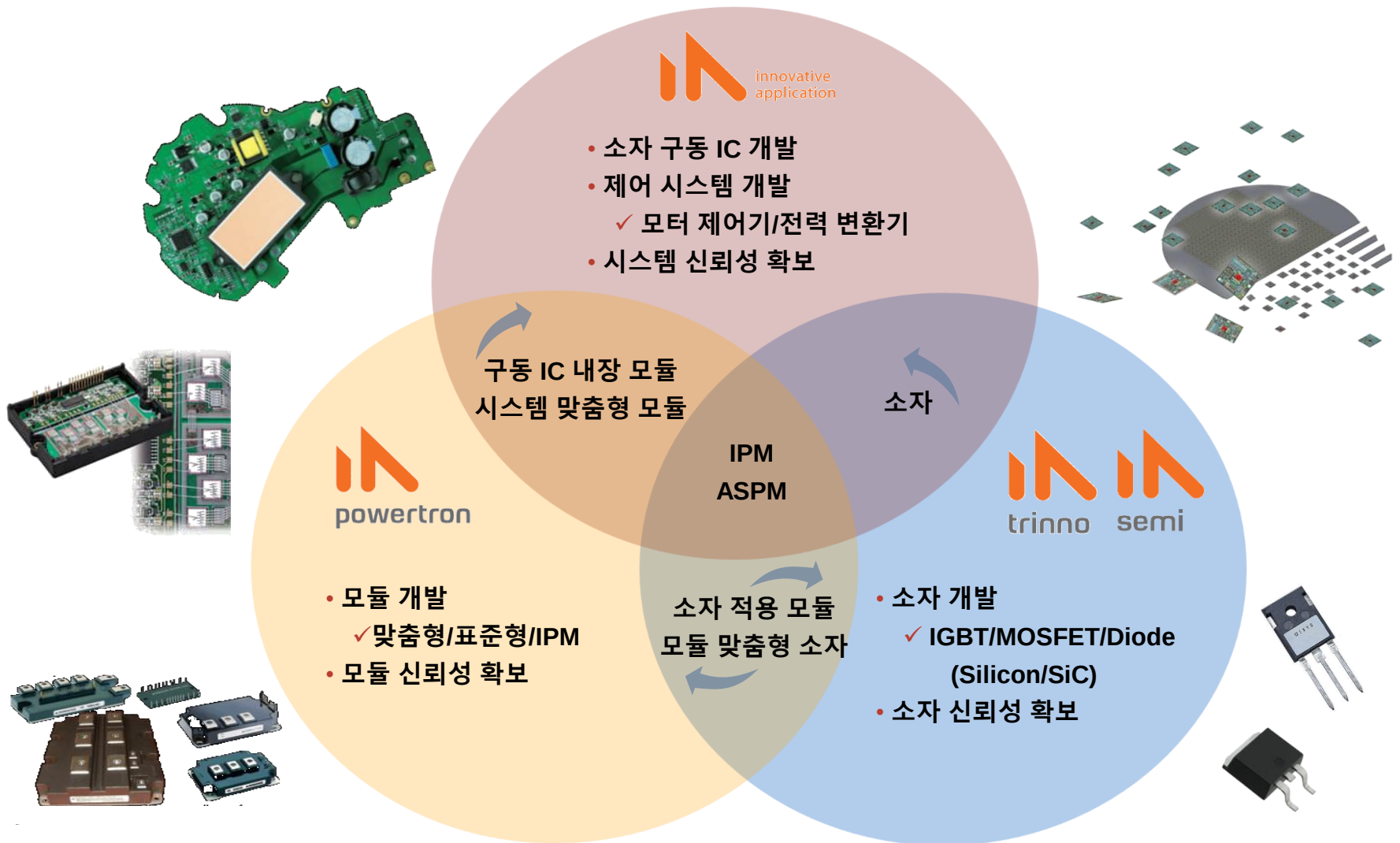
xEV (EV/HEV)

- **DC 컨버터 전용 모듈**
 - EV용 HV DC-DC 컨버터용 모듈
 - 1차측 : 650V Full-bridge MOSFET 모듈
 - 2차측 : 100V MOSFET 모듈 (2차측)
- **OBS용 SiC 모듈**
 - On Board Charge용 SiC 모듈
 - 1200V Bridgeless PFC SiC 모듈
 - 650V/1200V Full-bridge SiC 모듈
 - 650V Rectifier SiC 모듈
- **Traction Inverter용 IGBT 모듈**
 - 전기버스용 Traction Inverter IGBT 모듈
 - 1200V 2-Pack IGBT 모듈
 - 1200V Dual Side Cooling SiC 모듈

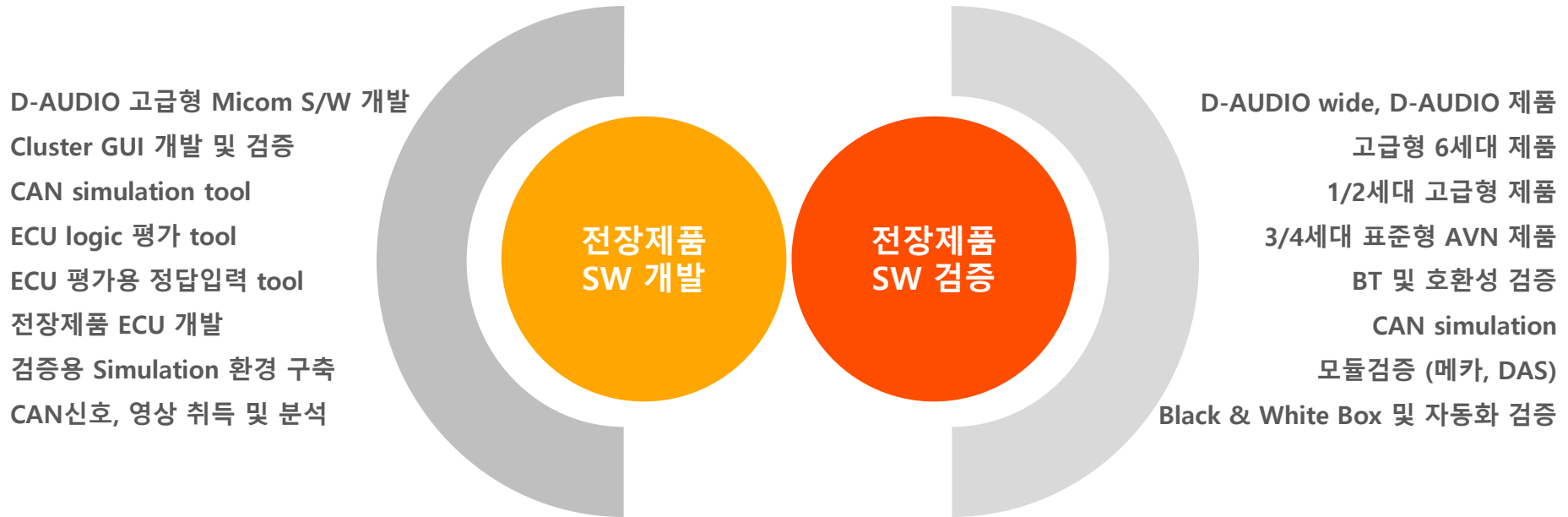


Industrial

- **IGBT 모듈**
 - UPS / 산업용 인버터 / 신재생에너지
 - 600V / 1200V ~600A
 - 2-Pack / 4-Pack / 6-Pack / PIM
- **Diode 모듈**
 - UPS / 산업용 인버터 / 신재생에너지
 - 400V / 1200V ~300A
 - 1-Pack / 2-Pack
- **신재생에너지용 파워 모듈**
 - ESS DC-DC 컨버터용 모듈
 - 650V Full-bridge SiC 모듈
 - 650V 1-Pack SJ MOSFET 모듈



현대 모비스 AUDIO/AVN 플랫폼 기반 S/W 개발, 디버깅 및 검증



검증 노하우

- 소프트웨어 테스트 전문가 보유
- 지속적 역량 강화 (테스트 지식 공유)
- 테스트 업무 프로세스 개발 및 개선
- 도구 기반 테스트, 검증 보고서 Review

검증 환경

- 유럽, 북미향 방송 송출기
- 재난방송, 교통정보 송출기
- GPS, DMB, FM방사 시스템
- 자동화 테스트 Bench 장비

소프트웨어 검증

● AVN/Audio



- 3/4세대 표준형 AVN, 1/2세대 고급형 AVN
- D-AUDIO, D-AUDIO wide

● Body-Chassis



- BCM, SMK, PAS, TPMS, CLUSTER

● ADAS, 능동안전



- AEB, SCC, PDW, SVM

● 호환성 검증



- Phone, iPod, Bluetooth, USB, Android Auto, CarPlay, App

시험/검증 기술지원



대량, 복합조건 점검기



차량 Simulation 환경



보행자인식 정답 입력



주차구획인식 평가

Create
the Future Technology!



감사합니다.

Disclaimer

본 자료는 투자판단을 위한 참고 자료로 작성되었으며, 본 자료에 포함된 예측정보는 현재의 사업환경을 바탕으로 당사의 경영계획 및 전략수정 등에 따라 달라질 수 있습니다.